

半導體工程系 微電子應用技優專班 四技 113 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級						三年級						四年級																				
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期																	
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數												
校共同必修課程			應修學分數 12學分	中文閱讀與表達(一)	2	2	中文閱讀與表達(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2																										
				實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	體育(一)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2																							
				體育(一)	0	2	體育(二)	0	2																																
				服務教育(一)	0	1	服務教育(二)	0	1																																
校訂通識課程	應修學分數 至少2學分	校訂通識/2/2 校訂(一)藝術美感探索、校訂(二)運算與程式設計、校訂(三)生命與倫理、校訂(四)走讀高雄、校訂(五)海洋科技與永續、校訂(六)創意與創新																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
博雅課程	應修學分數 14學分 (至少任選3課群)	博雅通識/學分數/時數																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
		博雅通識/學分數/時數																																							
學院共同課程 (由學院開課)			選修	工程實作實習/3/3；物理實驗與演示/1/3																																					
學院跨領域課程 (由學院開課)			選修	光：訊號與能源/3/3；機器人程式編碼與演算法概念/2/2；虛擬實境互動實務/1/3；3D列印實務/1/3；智慧科技應用專論/3/3；車用電子應用及實務/3/3；機光電半導體封測/3/3 半導體設備基礎技能實務/3/3；半導體設備元件儀控系統實務/3/3；半導體設備真空系統實務/3/3；半導體製程設備實務培訓/3/3																																					
必修	應修課程數 20門/ 應修學分數 53學分	電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	電子學(一)	3	3	電子學(二)	3	3							實務專題 (一)	3	3	實務專題 (二)	3	3																
		微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	工程數學(一)	3	3	電腦輔助電路設計與實驗	1	3																												
		普通物理(一)	3	3	普通物理(二)	3	3	半導體元件(一)	3	3	半導體製程與設備	3	3																												
		普通物理實驗(一)	2	3	普通物理實驗(二)	2	3	微電子電路實驗	1	3																															
系專業課程	應修學分數 至少 47學分	數位邏輯	3	3	C程式語言設計 與實習	3	3	可程式邏輯 控制實習	2	3																															
		半導體產業介紹/2/2 科技英文/3/3 3D繪圖與微電子創意應用/2/2 微控制器實習/1/3 電腦輔助工程設計與分析/3/3 電腦網路概論/3/3										向量分析/2/2 線性代數/3/3 半導體元件(二)/3/3 電磁學(一)/3/3 VLSI工具實務/2/2 嵌入式系統實習/2/3 虛擬圖控儀表實習/2/3 射頻電路設計與實習(一)/3/3 電腦網路概論/3/3 微控制器實習/1/3 專案實習/3/3 半導體設備基礎技能實務 半導體設備元件儀控系統實務										半導體設備真空系統實務/3/3 半導體製程設備實務培訓/3/3 光電元件量測暨封裝實習/2/3 太陽能光電技術/3/3 太陽能電池製程與應用/3/3 半導體元件製程與特性模擬/3/3 半導體量測實驗/2/3 半導體奈米技術/3/3 半導體封裝工程/3/3 半導體負電阻元件/3/3 半導體無塵室技術/3/3 VLSI電路設計實習/3/3 光電半導體元件/3/3 單晶片實驗/2/3 Python程式設計與實習/2/3 應用電子學/3/3 自動控制/3/3 數位訊號處理/3/3 複變函數/3/3 機率/3/3 半導體產業技術問題與實習導向/3/3 半導體產業實務見習與鏈結微學分/1/1 專案實習/3/3 學期實習-產業實習(一)/9/9 學期實習-產業實習(二)/9/9										發光二極體元件及其應用/3/3 感測網路應用實務/3/3 電機機械/3/3 伺服控制/3/3 薄膜技術/3/3 自動控制/3/3 微機電製程/3/3 訊號與系統/3/3 大數據資料庫應用實務/3/3 半導體設備/3/3 半導體構裝材料與製程簡介/3/3 產業問題導向學習/3/3 產業實務見習與鏈結/1/1 半導體產業技術問題與實習導向/3/3 半導體產業實務見習與鏈結微學分/1/1 專案實習/3/3 學期實習-產業實習(一)/9/9 學期實習-產業實習(二)/9/9									

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、必修 53 學分，選修 47 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之各類英檢成績。在學期間參加 2 次各類英檢考試，未通過者，須提出考試成績證明始得以下列其中一種方式通過：1.通過校內英語畢業門檻檢定考試。2.參加一期外語教育中心開設之短期英文加強課程，並符合課程簡章規定。3.修讀並通過就讀院系開設 2 學分以上全英授課專業課程 1 門。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分);多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。
- 五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認為外系課程學分。
- 六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：
 - 1.於就學期間，需通過相關專業檢定(證照之張數及類別如下：一張電機、電子類相關證照或二張資訊類相關證照)，附有證明文件，經審查合格，始得畢業。
 - 2.「半導體產業介紹」課程為必修科目。
 - 3.承認外系(非通識)選修學分至多 12 學分為專業選修，其中非本院開設之專業選修課程至多承認 6 學分。

